

厦门乾照光电股份有限公司

关于变更投资项目暨签署投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资项目概述

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过《关于投资VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目的议案》，于2018年12月12日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过《关于同意对外签署投资协议的议案》，并于2018年12月24日召开了2018年第二次临时股东大会审议通过前述两项议案。前述对外投资项目及投资协议（以下简称“原投资协议”或“原协议”）相关公告详见公司在巨潮资讯网披露的《关于投资VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目的公告》（公告编号：2018-120）、《关于同意对外签署投资协议的公告》（公告编号：2018-133）及《关于投资VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目的补充公告》（公告编号：2018-135）。

二、对外投资项目变更情况概述

在项目实施过程中，受市场客观情况、国家政策变化影响，结合公司战略发展方向，经过深入研究和审慎评估，公司拟将“VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目”调整为“Mini/Micro显示外延片、芯片及其他高端芯片研发与生产”方向，并签订新的投资协议。

三、投资协议的主要内容

公司及相关子公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署《Mini/Micro显示外延片、芯片及其他高端芯片研发与生产项目投资协议》（以下简称“新投资协议”），对原投资协议内容进行变更。

（一）新投资协议签约方

甲方：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会（以下简称“甲方”或“高新区”）

乙方：厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乙方”或“乾照光电”）

丙方：厦门乾照半导体科技有限公司（以下简称“丙方”或“乾照半导体”）

丁方：厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“丁方”或“乾照科技”）

（二）新投资协议主要内容

1、项目内容

原项目“VCSEL、高端 LED 芯片等半导体研发生产项目”调整为“Mini/Micro 显示外延片、芯片及其他高端芯片研发与生产”方向。

2、承诺指标及约定事项

协议各方对 2024-2031 年期间累计增量综合经济贡献及累计增量地方财力贡献重新约定相关考核条款。原投资协议相关承诺指标不再继续考核，相关政策支持的未执行部分不再执行。

3、其它

各方均确认，本协议作为原协议的调整，自本协议签署后，与原协议具有同等法律效力。本协议的约定与原协议及其项下相关约定不一致的，以本协议为准。本协议未约定事项，以原协议为准。

四、变更投资事项的审议情况

公司于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更投资项目暨签署投资协议的议案》。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次签署事项尚需提交股东大会审议通过，本次签署新投资协议不构成关联交易，

不构成重大资产重组。

五、对外投资项目变更对上市公司的影响

本次对投资项目建设内容的调整系基于行业环境变化及公司实际经营需求进行的审慎决策。此次调整符合公司战略发展规划和产业布局，有利于公司聚焦核心主业，提升核心竞争力。

六、对外投资项目的风险分析

本项目受国家政策、宏观经济、市场环境、技术变化等多种因素的影响，可能存在项目进度或者项目效益不及预期的风险。公司将密切关注对外投资进展，将深入了解和熟悉行业的政策规划和市场环境等相关事项，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《Mini/Micro 显示外延片、芯片及其他高端芯片研发与生产项目投资协议》。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日